

股票代码：688519

股票简称：南亚新材

南亚新材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	线上参与“2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会”活动的南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资者。
时间	2024年11月13日 15:00-16:30
地点	上证路演中心 (http://roadshow.sseinfo.com)
上市公司接待人员姓名	董事长：包秀银 总经理：包欣洋 董事会秘书：张柳 财务总监：解汝波
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问 1：公司在人工智能服务器领域的布局情况是怎样的？在这一领域中，公司取得了哪些显著的成果和进展？</p> <p>答：公司积极抓住人工智能技术带来的巨大机遇，与重要终端建立了紧密的合作关系。通过双方的共同努力，公司成功研发并完成了面向新一代人工智能服务器的板材的开发与认证工作。目前技术已达行业领先水平，并顺利进入小批量交付阶段，且市场需求呈快速增长的态势。此外，公司还在积极与合作伙伴协作，共同开发面向下一代 AI 服务器板材，这些项目的量产预研工作正在稳步推进。</p> <p>问 2：公司 2024 年前三季度利润增长的原因？</p> <p>答：公司前三季度利润增加主要系公司持续优化产品结构，积极拓展市场与业务，产品销量、营业收入、毛利率较上年同期均存在较大改善，盈利能力提升；同时享受增值税进项税额加计抵减政策增加其他收益及聚焦研发项目、优化研发投入等综合影响所致。</p>

问 3: 2024 年应付账款、应收账款、存货的周转效率是怎样的?

答: 2024 年前三季度应付账款、应收账款、存货周转天数分别为 71 天, 136 天, 57 天, 与 2023 年相比应付账款周转天数减少 18 天, 主要系采购规模下降及部分供应商账期调整影响; 应收账款周转天数减少 23 天: 主要是受市场回暖影响, 客户回款周期逐渐恢复正常及收款效率提升影响; 存货周转天数持平。

问 4: 公司 2024 年前三季度计提减值准备情况是怎样的?

2024 年前三季度确认的信用减值损失和资产减值损失总额为 1,307.91 万元, 其中存货跌价准备计提为 1,269.07 万元, 主要为个别结构性产品市场竞争加剧, 导致毛利率收窄影响。

问 5: 封装材料在 2024 年的主要成绩以及 2025 年的展望?

答: 截至目前, 公司封装材料已经在 Coreless, MiP, eMMC 实现小批量订单; 摄像头模块和指纹识别已获国际手机品牌商的认可, 即将 NPI, 并在国内 OSAT 和 Chipmaker 端逐步开展材料认证工作, 尤其在 PC DRAM BOC 上获得国内半导体行业核心客户的高度认可。初期我司聚焦在模块类和 Memory 芯片上起量, 下一步侧重高端的 mDRAM, NAND Flash 和处理器芯片, 如 LPDDR, UFS, AP 等。

问 6: 公司整体稼动率情况? N6 厂及南通工厂的建设进度情况如何?

答: 受国际形势和宏观经济环境等因素影响, 公司整体稼动率在 7 成左右。截至目前, N6 工厂已释放 30 万张产能。公司将根据既定战略规划, 有序推进 N6 厂其余产线及南通工厂建设。

问 7: 公司在光伏新能源领域, 有什么新的进展?

答: 光伏逆变器在光伏能源直流和交流的转换中承担着重要的角色, 其逆变器的高压、高功率密度化, 一直是光伏降本增效的重要革新方向。公司中 Tg 无铅材料已大批量应用在光伏逆变器 1500V 高压系统; 同时, 今年中 Tg CTI600 材料, 已通过光伏龙头企业的测试, 具有持久的层间耐高压能力, 可适用在新一代 2000V 高压系统。目前处于小批量应用阶段。

问 8: 公司车载领域 2024 年度同比增长如何?

答: 公司前几年车载领域加大材料推广认证力度, 2024Q1-Q3 车载产品销售较同期增长明显。主要增长点在新新能源汽车电池管理、车载充电机、电控等部件, 通过整车厂自研或 Tier1, 产品最终应用在国内外头部新能源汽车客户上。

	<p>问 9：目前国内快速的推动的智算中心，南亚新材有哪些产品布局？</p> <p>答：南亚新材 NY-P1、NY-P3 在 GPU 加速卡及交换板均已稳定的量产交付。针对 112G 产品 NY-P4 已率先在国内预研的计算产品 GPU 模组上中批量使用且品质及供货稳定。在接下来的 224G 产品我司有 NY-P5 现已开发完成正面向市场推广。</p> <p>问 10：由于外部环境的不确定性，目前国内通讯终端都在开发自研芯片，南亚新材针对这一新变化在产品上有没有新的突破去应对？</p> <p>答：针对国内大尺寸芯片可能存在的要求 PCB 尺寸稳定性更高，我司从 ML、VLL、ULL、ELL 等级全方面布局了 Low CTE 材料。目前 LL 级材料 NY6180 已在无线 AAU 及 BBU 上大量应用；针对 56G 及 112G 应用，重点推出了 NY6666、NY8888、NY8888Q 等高性价比的 Low CTE 材料，应对后续算力产品对于高可靠性及电性能的高标准要求。</p> <p>问 11：在消费性领域 AI PC/NB 方向，南亚新材是否有布局？</p> <p>答：消费性领域 AI PC/NB 方向也是我司重点拓展的业务方向。公司 Mid loss+材料已应用于国内头部品牌 AI NB 旗舰机型，并持续量产发货；且该类材料已进入头部两家 NB ODM 产品选材 AVL，并多机型 NPI+量产中。</p> <p>问 12：海外和台湾高速材料市场，南亚新材是否有开拓，进展如何？</p> <p>答：公司已招募本土化人才创建台湾市场开拓团队，并取得部分台湾 ODM 和北美终端材料认可；且已参与两家芯片公司（AMD、Intel）Gen6 项目材料测评。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024 年 11 月 14 日